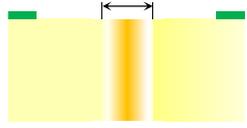
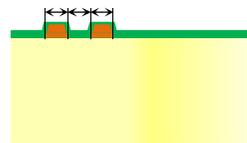
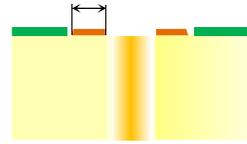




Capacité Technique. Circuits Simple Face

Caractéristiques	Minimum	Maximum	Tolerance	Notes
Finitions de surface: Hal sans plomb (SnCuNi) Étain chimique (Imm.Sn) (*) Argent chimique (Imm.Ag) NiAu chimique (ENIG)	Ni: 3 µm Au: 0,04 µm	Ni: 7 µm Au: 0,07 µm	-	Alliage SN100C (*) Externalisée Non disponible pour des circuits avec base d'aluminium
Sérigraphié finitions: Épargne photosensible Marquage des composants Graphite Masque peelable	-	-	-	Différentes couleurs Différentes couleurs
Base de substrat: FR-4 Tg Standard CEM-1 IMS (Aluminium)	130 °C	140°C	-	Selon le fabricant
Cuivre base FR-4 Tg Standard CEM-1 IMS (Aluminium)	17 µm 35 µm 35 µm	70 µm 35 µm 70 µm	-	Sur demande (délai special): 105 microns Selon le fabricant
Le diamètre du trou (substrat de base) 	300 µm (FR-4 et CEM-1) 700 µm (IMS)	-	+ 0,10 / - 0,05 mm	Ou Tolérance équivalent
Largeur et isolement du conducteur (cuivre base) 	100 µm (17 µm) 100 µm (35 µm) 200 µm (70 µm)	-	± 25% ± 25% ± 30%	-
Couronne de cuivre (cuivre base) 	100 µm (17 µm) 125 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	-	-	Recommandation: pour la surface de soudage proprement dite (trous des composants) ≥ 200 microns



Capacité Technique. Circuits Simple Face

Caractéristiques	Minimum	Maximum	Tolerance	Notes
Distance Trou conducteur	200 μm	-	-	-
Distance d'un conducteur au bord de la plaque (Détourage)	150 μm	-	-	-
Décalage entre le cuivre et le trou	-	-	$\pm 100 \mu\text{m}$	-
Décalage entre le contour et le trou	-	-	$\pm 150 \mu\text{m}$	-
Distance d'un conducteur à l'axe théorique et le scoring	500 μm	-	-	-
Diamètre maximum pour couvrir avec de la laque pelable	0,30 mm	1,80 mm	-	-
Distance entre le revêtement pelable et le pad	0,80 mm	-	-	-

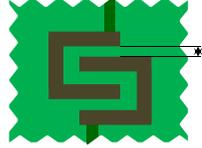
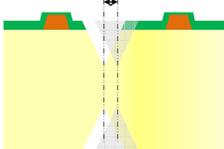
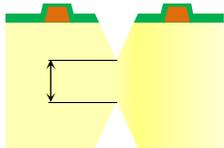
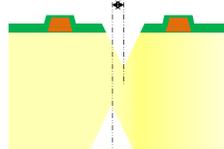
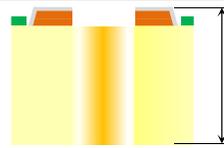
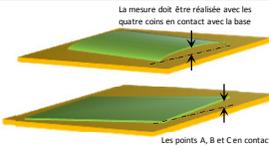
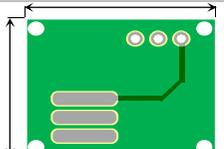


Capacité Technique. Circuits Simple Face

Caractéristiques	Minimum	Maximum	Tolerance	Notes
Couronne épargne de soudure	50 μm	-	-	-
Largeur de la ligne d'épargne de soudure	100 μm	-	-	-
Distance d'épargne de soudure au conducteur	50 μm	-	-	-
Décalage entre l'épargne de soudure et de cuivre	-	-	$\pm 150 \mu\text{m}$	-
largeur de lignes marquage de composants	100 μm	-	-	-
Décalage entre les composants et le cuivre	-	-	$\pm 200 \mu\text{m}$	-
Largeur des conducteurs de graphite	600 μm	-	-	-



Capacité Technique. Circuits Simple Face

Caractéristiques	Minimum	Maximum	Tolerance	Notes
Séparation entre les conducteurs de graphite 	400 µm	-	-	-
Tolérance de positionnement (axe de la lame) 	-	-	± 150 µm	-
Épaisseur centrale (core) après scoring 	200 µm	-	± 150 µm	Standard: 300 µm
Décalage entre les lames de scoring 	-	-	± 150 µm	-
Épaisseur finale 	0,50 mm 1,0 mm 1,0 mm	3,2 mm 1,6 mm 3,0 mm	± 10 % (e > 1,0 mm) et ± 100 µm (e ≤ 1,0 mm) ± 10 % ± 10 %	Pour FR-4 Pour CEM-1 Pour IMS
Arc et courbure  <small>La mesure doit être réalisée avec les quatre coins en contact avec la base</small> <small>Les points A, B et C en contact avec la base</small>	-	1,0 % de la diagonale	-	-
Dimensions des produits finis (entouragé) 	15 x 15 mm	600 x 500 mm	< 30 mm: ± 0.10 mm < 120 mm: ± 0.15 mm >120 mm: ± 0.20 mm	-
Autres	-	-	-	Selon le Norme IPC-A-600 révision G